

405 502



Int. Cl.:	B65B

D. José Mateu Sebastiá y D. Juan Mitjans Mitjans, ambos de nacionalidad española, establecidos en Vilafranca del Panadés (Provincia de Barcelona), calle Amalia Soler n.ºs. 121/123, solicitan registrar una Patente de Invención, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO".

-----

5 El objeto de la presente solicitud de Patente de Invención lo constituye un nuevo procedimiento para el envasado hermético de objetos, mediante el recubrimiento de una lámina termoplástica, que se reblandece por calor y se adapta al artículo a envasar por efecto del vacío, que se practica a través de un estrato o placa de porosidad variable, adheriéndose a la misma en virtud de tal reblandecimiento y con la ayuda de una fina película de recubrimiento convenientemente distribuída por impregnación, o por zonas, sobre una o ambas superficies de la placa de base.

10 Hasta el presente se han utilizado, para este sistema de envasado al vacío, placas, preferentemente de cartón, que presentan múltiples y pequeñas perforaciones adecuadamente practicadas para facilitar la aspiración a través del cartón, a fin de lograr el moldeo de la lámina termoplástica sobre el objeto a envasar, la cual se  
15 adhiere al cartón de base, que ha sido previamente encolado.

Más recientemente se ha utilizado, en vez del cartón perforado, cartón poroso y aprovechando la pastosidad que adquiere la lámina termoplástica al ser calentada, conseguir, por presión neumática o aspiración, el moldeo sobre las piezas, pero dicho sistema tiene el  
20 inconveniente de que la lámina plástica se adhiere a las piezas envasadas al propio tiempo que al cartón.



El hecho de utilizar placas de cartón perforado, implica una operación más en el proceso de fabricación, que lo encarece, teniendo, además, el inconveniente de que dichos agujeros, si bien facilitan la aspiración para practicar el vacío, también dan origen a la penetración de la humedad que altere los artículos envasados por este sistema.

El nuevo procedimiento de envasado hermético, objeto de la presente solicitud de Patente de Invención se refiere tanto a las características de la placa de cartón en sí, como a las de la película que recubre la parte superior de dicha placa o ambas caras, para facilitar la adherencia de la lámina termoplástica que se amolda al objeto u objetos a envasar y se adhiere a la referida placa de base.

Para la formación de la placa de base se utilizan, según la Patente que ahora se solicita, cartones de una densidad de porosidad con pasos variables, para efectuar la aspiración a través de los mismos.

Sobre dichos cartones se distribuye, por una o ambas caras, una fina película de recubrimiento, cuyo grueso varía según el grado de porosidad deseado, distribuyéndola por impregnación total o por zonas.

La película está constituida a base de resinas acrílicas, cloruro de acetato de polivinilo, o similares, a las que se han agregado dispersantes, a fin de que dicha película no obture por completo los pasos propios de la porosidad del cartón.

Los componentes de la película tienen que seleccionarse de manera que entren en estado pastoso bajo la misma temperatura que es necesaria para el moldeo de la lámina de plástico, en cuyo momento, por efecto de dicho calor, se cierran los poros del cartón y se adhiere al mismo la lámina termoplástica.

Por la acción del calor que determina el reblandecimiento de la lámina termoplástica que forma el envase propiamente dicho sin que ésta alcance grado de pastosidad, se consigue también el reblandecimiento de la película de recubrimiento hasta adquirir el grado de pastosidad merced al cual, al mismo tiempo que se logra una dilatación de la estructura microporosa del cartón para facilitar la succión o aspiración directa a través del mismo, sin necesidad de perforaciones ni taladros previos, se produce la íntima unión del



50 recubrimiento con la lámina recubridora y la penetración de ambas  
en los poros del cartón a los que se adhiere, pero con la particu-  
laridad de que los poros del cartón quedan cerrados al final de la  
operación de envasado.

65 La carencia de taladros o perforaciones asegura una estanquei-  
dad de las cámaras o alveolos en que se alojan los objetos una vez  
recubiertos con la lámina termoplástica, conformada sobre los mismos.

70 Se sobreentiende que la clase de cartón utilizado para formar  
el soporte de base del envasado por vacío podrá variar, siempre que  
sea de estructura microporosa para facilitar la aspiración a través  
de las zonas con menor impregnación. Igualmente se sobreentiende que  
el tipo de resinas acrílicas utilizadas para el recubrimiento de la  
placa de base podrá variar, con tal de que sean de una composición  
fácilmente reblandecible por efecto del calor que se suministra a  
la lámina termoplástica para lograr su moldeo sobre las piezas a  
envasar.

75 La distribución de la película de recubrimiento podrá realizar-  
se por diversos métodos, con tal de conseguir una distribución más  
o menos regular, de grueso variable, que no obture por completo los  
poros del cartón.

80 La Patente de Invención, por: "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL EN-  
VASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMO-  
PLASTICA ADAPTABLE POR VACIO", cuyo privilegio de explotación en  
España y sus Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de  
20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan  
en las siguientes,

85 R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS,  
MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO",  
caracterizado por el hecho de que la placa de cartón poroso emplea-  
da para la formación del soporte de base, sobre la que se colocan  
90 los objetos a envasar recubriéndolos con una lámina termoplástica  
que se reblandece por calor y se moldea sobre los mismos por efecto  
del vacío practicado a través de dicha placa, es de una densidad de  
porosidad con pasos variables, para facilitar la aspiración a tra-  
vés de dicha placa; cuya estructura; bajo el efecto del calor, se  
95 modifica para permitir la práctica del moldeado por vacío y el cic-

*Re*



rrc posterior de dichos poros.

2ª.- "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO", según la 1ª reivindicación, caracterizado por el hecho de que sobre  
100 la placa de base formada por cartón poroso se distribuye , por im-  
pregnación total o por zonas, una fina película de recubrimiento, cuyo grueso varía según el grado de porosidad deseado, seleccionán-  
dose los componentes de la película de manera que entren en estado  
105 pastoso bajo la misma temperatura que es necesaria para el moldeo  
de la lámina de plástico, en cuyo momento y despues de efectuado  
el vacío, se cierran los poros del cartón por efecto de dicho calor  
y se adhiere al mismo la lámina termoplástica que constituye el en-  
vase.

3ª.- "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO", según la 1ª y 2ª reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que  
110 la película está constituida, preferentemente, por resinas acríli-  
cas, cloruro de acetato de polivinilo, o similares, a los que se  
han agregado dispersantes, a fin de que dicha película de recubri-  
115 miento no obture por completo los poros propios del cartón.

4ª.- "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO", según las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho  
120 de que la película de recubrimiento del soporte de cartón, al adqui-  
rir el grado de pastosidad, se une íntimamente a la lámina de recu-  
brimiento plástico reblandecida, y al propio tiempo penetra en el  
interior de los poros del soporte de cartón, cerrándolos y uniendo  
íntimamente, al enfriarse, la lámina de recubrimiento al soporte.

5ª.- "NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO HERMETICO DE OBJETOS, MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE LAMINA TERMOPLASTICA ADAPTABLE POR VACIO".-  
125 Tal como se ha descrito en la presente memoria.

AS

405502

21



Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona a 21 JUL 1972

P.A. de D. José Mateu Sebastiá y

D. Juan Mitjans Mitjans

JUAN B. RENTER BIDAURA

Rey